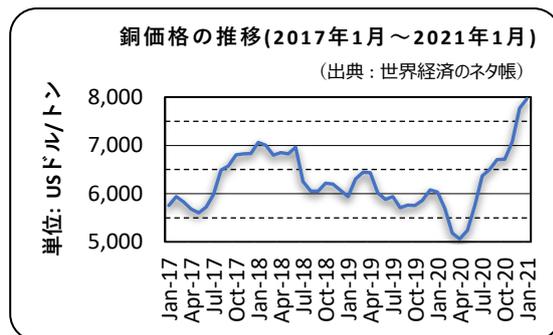


マイコン組込み開発をキーテクノロジーとする弊社の電子機器製品は、主にプリント配線基板、ハーネス、半導体電子部品、モールド・金属筐体などで構成されています。今回は、これら部品の市場の動向と弊社の取組みについてご紹介させていただきます。

市場の動向

～銅地金の価格高騰～

最近、銅地金の価格が著しく高騰しています。熱伝導率に優れた特性を持つ銅は、プリント配線基板・ケーブル・数多くの電子部品に使われています。データでは、2020年4月を底とし約1.6倍に跳上がり、この傾向は2022年までは続くと推察されております。この影響は数カ月先にケーブルの価格上昇に繋がりそうなので注意深く監視しています。



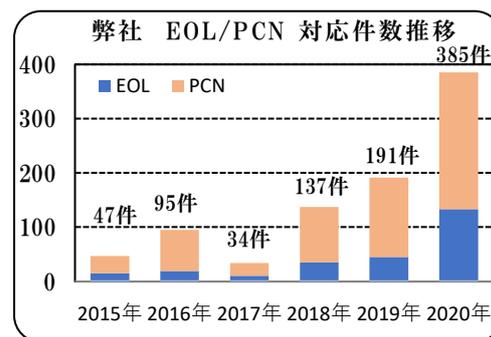
～電子部品・鋼板材料の納期延伸～

昨今、リン青銅の中国買占めにより材料供給が間に合わず、コネクタ・コンタクト及び基板部品の生産規模縮小のニュースが大きな話題となっています。この影響は納期延伸に現れ、通常納期に対してかなり長納期化すると予測しております。商社様からの市況動向を定期的に入手することで、長納期部品も早めの対応をして行く必要があり、社内では、例えばコンタクト部品は1年先までの所要を先行手配する等の対応をしています。

また、鋼板材料(SECC)も ASEAN諸国で品薄になりつつあるとの情報があります。国際市場の鉄鋼需給は逼迫しており「鉄不足」の状態が続いているようです。銅地金と同様に納期、価格の推移に注意が必要です。

～部品の生産終息と変更件数の増加～

デバイスメーカーによる生産性改善などの理由から生産設備・方法・材料・生産拠点などが変更となるPCN(Product Change Notice)や、ライフサイクルの短縮化による生産終息部品(End of Life)の対応件数が、今までにない増加しています。製品を安定して供給できるように部品の変更情報、特に部品終息の情報は供給元の情報をいち早く入手するために、商社様よりの情報提供依頼及び弊社から積極的に情報確認(年2回)を行っています。



弊社の取組み

部品や材料市場の急激な変化に対応して、次のような取組みを実施しています。

- 市場動向をいち早くお知らせし、お客様と一緒に課題の対応を考えます
- 部品終息に対応して 互換部品の採用をご提案します
- 製品の機能性・コスト・入手性バランスを重視したリファイン設計のご提案をします
- グローバルネットワークで、部品の確保に努めます

部品の生産終息でお困りの場合は、弊社までご相談ください。